

9月22日（水） プログラム一覧

id	date	start	title	author_gr	affiliation_gr
22A1-1	9月22日	9:30	配線板・インターポーザー-1 ベンダブル性を有する高密度多層ビルドアップ基板の開発	○種子田 浩志、今藤 桂、清水 規良、片桐 規貴	1) 新光電気工業株式会社
22A1-2	9月22日	9:50	配線板・インターポーザー-1 HBMデバイス搭載を想定したCavity構造パッケージにおけるサブストレート基板の反り最適化	○森 裕幸1、小原 さゆり1	1) 日本アイ・ピー・エム株式会社
22A1-3	9月22日	10:10	配線板・インターポーザー-1 導電性ペーストを用いた一括積層による高信頼Any Layer基板技術の開発	○酒井 泰治1、飯田 憲司1	1) 富士通インターコネクテクトテクノロジーズ株式会社
22A2-1	9月22日	10:50	配線板・インターポーザー-2 スプレー下の銅エッチングプロセスのEIS解析	○奥山 理央1、吉原 佐知雄1、野尻 尚克2、菊地 義弘2、白岩 昭吾2	1) 宇都宮大学 2) 株式会社大昌電子
22A2-2	9月22日	11:10	配線板・インターポーザー-2 銀シード・セミアディティブ工法で作製した銅配線のエレクトロケミカルマイグレーション耐性	○新林 昭太1、村川 昭1、深澤 憲正1、富士川 亘1	1) DIC株式会社
22A2-3	9月22日	11:30	配線板・インターポーザー-2 アンダーフィル材で端子を保護したセラミックBGAパッケージ実装サンプルの熱衝撃サイクル試験結果	○篠崎 孝一1	1) 宇宙航空研究開発機構
22A3-1	9月22日	15:20	高速高周波・電磁特性技術-1 UWB用広帯域アンテナにおける遮断帯域形成用共振器の小型化の検討	○古川 宙磨1、越地 福朗1	1) 東京工芸大学 工学部
22A3-2	9月22日	15:40	高速高周波・電磁特性技術-1 衣服への組み込みのための導電性布を用いたフレキシブル広帯域半円台形不平衡ダイポールアンテナ	○富澤 将哉1、越地 福朗1	1) 東京工芸大学 大学院 工学研究科
22A3-3	9月22日	16:00	高速高周波・電磁特性技術-1 透明アンテナ用ITO透明導電膜のアニール処理によるシート抵抗の低減とアンテナの放射効率改善の検討	○山田 友里1、越地 福朗1、安田 洋司1、山田 勝実1、内田 孝幸1	1) 東京工芸大学大学院 工学研究科
22A4-1	9月22日	16:40	高速高周波・電磁特性技術-2 マイクロストリップ線路におけるミリ波伝送の損失要因解析技術の開発	○馬路 哲1	1) 住ベリサーチ株式会社
22A4-2	9月22日	17:00	高速高周波・電磁特性技術-2 新規低誘電PPEビルドアップフィルムを用いたフィルタ基板の作製と高周波伝送特性	○角谷 武徳1、高 明天1、関口 翔也2、松村 聡子2、大城 康太2、三島 翔子2、石川 信広2、緒方 寿幸2、Erdoğan Serhat3、Ali Muhammad3、	1) 太陽インキ製造株式会社 2) 太陽ホールディングス株式会社 3) ジョージア工科大学
22B1-1	9月22日	9:30	パワーエレクトロニクス-1 Ag-Cu焼結ペーストの低加圧接合における焼成雰囲気の影響	○熊谷 圭祐1、深江 信邦2、武田 光市2	1) (株)日本スベリア社 2) (株)応用ナノ粒子研究所
22B1-2	9月22日	9:50	パワーエレクトロニクス-1 非加圧焼結ダイアタッチによる熱信頼性に対する焼結密度の影響	○加藤 諒1、奥田 真利1、森 崇充1、三並 淳一郎1、櫻井 哲郎1、福井 太郎1	1) 株式会社大阪ソーダ
22B1-3	9月22日	10:10	パワーエレクトロニクス-1 パワー半導体実装用接合材料の基礎物性と信頼性評価法	○山田 靖1,5、八坂 慎一2,5、大浦 賢一3,5、東条 三秋4,5	1) 大同大学 2) 神奈川県立産業技術総合研究所 3) 先端力学シミュレーション研究所
22B2-1	9月22日	10:50	パワーエレクトロニクス-2 パワーエレクトロニクスに向けたAu/CuPdスパッタ膜の高温特性評価	○根本 俊介1、八坂 慎一1、三橋 雅彦1	1) (地独) 神奈川県立産業技術総合研究所
22B2-2	9月22日	11:10	パワーエレクトロニクス-2 結晶粒を微細化したAl合金ワイヤ適用によるパワーサイクル寿命の向上	○浦地 剛史1、柳本辰則1、中島泰1、三苦修一2、市川司2	1) 三菱電機株式会社 2) 田中電子工業株式会社
22B2-3	9月22日	11:30	パワーエレクトロニクス-2 Analysis of Identifying Specific Position of Voids in Multiple Solder Layers of Power Module by 2D X-ray inspection device	○Wei Min PAN1、Hiroshi ONODERA1、Itaru JIMBO2	1) SHIIMA Electronics Inc. 2) Advisor with SHIIMA Electronics Inc.
22B3-1	9月22日	15:20	カーエレクトロニクス SnペースはんだのCu含有率がはんだ接合部のエレクトロマイグレーションに与える影響	○山田 晃大1、奥田 風優1、小笠原 拓海1、近藤 直希1、山中 公博1	1) 中京大学 工学部 電気電子工学科
22B3-2	9月22日	15:40	カーエレクトロニクス 直流電流の反転周期がはんだ接合部エレクトロマイグレーションに与える影響	○前田 和樹1、浅倉 健太1、山中 公博1	1) 中京大学 工学部 電気電子工学科
22B3-3	9月22日	16:00	カーエレクトロニクス LEDとSi太陽電池だけから成るEV制御用超高出力トランジスタ	○岡本 研正1、中野 逸夫2、細川 正美3、奥野 敦史4	1) 香川大学 2) 岡山大学 3) 光半導体デバイス応用技術研究所
22B3-4	9月22日	16:20	カーエレクトロニクス 高耐圧両面直接冷却型パワーモジュール向け導体積層絶縁シートの部分放電特性	○楠川 順平1、露野 円丈1、徳山 健1、中津 欣也1、松下 晃2、石井 利昭2	1) 株式会社日立製作所研究開発グループ 2) 日立Astemo株式会社
22C1-1	9月22日	9:30	めっき技術-1 断続的に印加される微弱電流がピアフィリング性能に与える影響	○杉岡 駿1、吉川 純二1、長尾 敏光1、片山 順一1	1) 奥野製薬工業株式会社
22C1-2	9月22日	9:50	めっき技術-1 超臨界CO2混合めっきのTSVへの適用に向けた電気化学的考察	○樋口 和人1,2、Tso-Fu Mark CHANG2、曾根 正人2	1) (株)東芝 生産技術センター 2) 東京工業大学 科学技術創成研究院
22C1-3	9月22日	10:10	めっき技術-1 Agめっき固相拡散接合の接合強度向上メカニズムの検討	○山崎 浩次¹、井島 喬志²	1) 三菱電機株式会社先端技術総合研究所 2) 三菱電機株式会社通信機製作所
22C2-1	9月22日	10:50	めっき技術-2 Ni電析における添加剤による表面酸化と応力の制御	○山田 結平1、薦田 凌輔1、岡本 尚樹1、齊藤 文靖1	1) 大阪府立大学大学院工学研究科物質・化学系専攻 化学工学分野
22C2-2	9月22日	11:10	めっき技術-2 セルロースナノファイバ含有ニッケル電解複合めっきの共析機構に関する初期的考察	○飯岡 諒1、荘司 郁夫1、小林 竜也1	1) 群馬大学 大学院理工学府
22C2-3	9月22日	11:30	めっき技術-2 無電解Co-W-Bめっき液中のW濃度が析出性に与える影響	○伊井 義人1、小田幸典1、橋本滋雄1	1) 上村工業株式会社
22C3-1	9月22日	15:20	マイクロメカトロニクス実装技術 小型原子時計用ガスセルのためのSiとサファイアの低温接合	○倉島 優一1、柳町 真也1、松前 貴司1、前田 敦彦1、高木 秀樹1、日暮 栄治1	1) 産業技術総合研究所
22C3-2	9月22日	15:40	マイクロメカトロニクス実装技術 原子時計の小型化に向けた回折格子の作製と等方性評価	○穂苅 遼平1、レハクハウツー1、武井 亮平1、日暮 栄治1	1) 産業技術総合研究所
22C3-3	9月22日	16:00	マイクロメカトロニクス実装技術 小型・高感度温度センサアレイのためのカンチレバー式焦電素子構造に関する研究	○千田 優大1、海法 克享1,2、高松 誠一1、伊藤 寿浩1	1) 東京大学 2) セイコーホールディングス株式会社
22C4-1	9月22日	16:40	ものづくりセッション MSAP用微細配線形成エッチング液	○長野 暢明1、文蔵 隆志1	1) 株式会社 JCU
22C4-2	9月22日	17:00	ものづくりセッション 低温・短時間硬化接着剤	○伊達 仁昭1、徳平 英士1	1) 日邦産業株式会社
22C4-3	9月22日	17:20	ものづくりセッション はんだ実装可能な導電性銅ペースト	○久保田 和宏1、田上安宣1	1) 日油株式会社